

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-088

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司临时键合胶首获客户订单的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）先进封装材料-临时键合胶产品于近期首次收到国内某主流晶圆厂客户的采购订单，此前该产品型号以海外进口为主。这是继今年6月公司半导体封装PI产品获得批量订单之后，第二款半导体先进封装材料在客户端实现销售。本次订单的签署，进一步彰显下游客户对公司产品创新、体系管理、产业化及客户服务能力等各方面的认可，将持续巩固公司在半导体先进封装材料行业的产品优势，夯实公司在进口替代类创新材料平台型企业领域的竞争优势。

临时键合胶是将晶圆和临时载板黏接在一起的中间层材料，是晶圆减薄的关键材料。临时键合胶可用于需要在减薄晶圆上制造再布线层的晶圆级封装，或需要在减薄晶圆上进行CMP等TSV相关工艺的2.5D/3D封装。目前，该产品进口依赖度极高，国产化需求十分迫切。依托于公司成熟的有机合成和高分子合成技术经验，公司已突破临时键合胶耐高温(300℃以上)、低挥发份等关键技术，同时已实现该产品上游核心原材料及添加剂的国产供应或自制替代。

在产能布局上，公司现拥有年产110吨的临时键合胶（键合胶+解键合胶）产能规模，具备量产供货能力，能够满足客户端持续订单需求。

本次首获的临时键合胶订单涉及金额数百万元，暂未对公司2024年经营业绩产生重大影响。后续公司将及时跟进上述订单的执行情况并履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年11月20日